

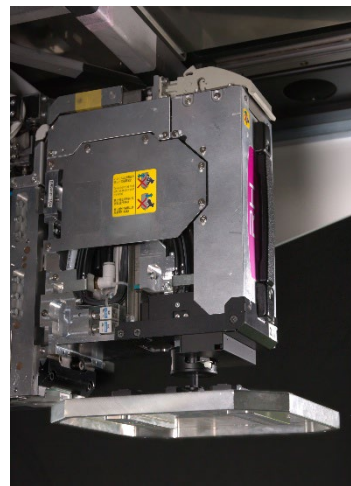
## 确立了 AI 服务器相关设备用大型重型元件的贴装技术

~行业首创，可处理 200×200mm、2.0kg 的大型重型元件~

AI 服务器相关设备的市场需求正在随着生成式 AI 的普及而不断增长。本公司株式会社 FUJI（公司总部：爱知县知立市、代表取缔役社长：五十棲 丈二、以下简称“FUJI”）正在不断强化电子元件贴装机器人(贴片机)、锡膏印刷机及自动化技术相融合的综合解决方案。此次，本公司采用电子元件贴装机器人“NXTR”和“AIMEXR”的标准配置，在行业内率先<sup>※1</sup> 确立了 200×200mm、2.0kg 的大型、重型元件的贴装技术。



FUJI 的电子元件贴装机器人  
NXTR S 机型



大型重型元件

贴装大型重型元件的场景

### ■ 研发背景

随着生成式 AI 的普及，AI 服务器及数据中心相关设备正在朝着高性能化方向加速发展。在这种发展潮流之下，GPU<sup>※2</sup>、ASIC<sup>※3</sup> 和 HBM<sup>※4</sup> 等元件相结合的 AI 半导体封装的大型化以及能够大幅降低功耗的光电融合等新一代先进封装技术(CPO<sup>※5</sup>)也正在逐步得到应用。这使得电路板及贴装元件也必须满足大型化、重型化的发展需求。

FUJI 以“零贴装界限”为目标，持续推进技术研发，逐步突破贴装工序中的各种技术瓶颈。此次，在本公司内部的评估条件下，我们成功确立了针对 200×200mm、2.0kg 的大型、重型元件的表面贴装技术，进一步拓展了 AI 服务器相关设备以及下一代电子产品制造中对新的贴装需求的适用范围。

### ■ 未来展望

今后，FUJI 还将继续紧跟元件进一步向大型化和重型化发展的趋势，进一步扩大相关技术的应用范围。本公司将秉承“零贴装界限”的理念，继续推进电子元器件贴装技术的研发。我们将根据用户遇到的课题量身定制最优解决方案，为以 AI 服务器相关设备为首的新一代电子产品制造的发展做出贡献。

※1 本公司的调研结果(截止到 2026 年 7 月 30 日)

※2 GPU (Graphics Processing Unit)：能够高速执行 AI 等高级运算处理的处理器

※3 ASIC (Application Specific Integrated Circuit)：专为特定用途而设计和优化的半导体

※4 HBM (High Bandwidth Memory)：采用堆叠结构、可实现高带宽的数据存储器

※5 CPO (Co-packaged Optics)：将半导体与光通信器件集成封装的先进封装技术

## 公司概况

公司名称： 株式会社 FUJI

法人代表： 代表取缔役社长 五十棲 丈二

公司地址： 爱知县知立市山町茶碓山 19 邮编： 472-8686

成立时间： 1959 年 4 月

事业内容： 电子元件贴装机器人(贴片机)以及数控机床的研发、制造、销售

注册资金： 58.78 亿日元

网 站： <https://www.fuji.co.jp/cn/> (官方网站)

<https://smt.fuji.co.jp/cn/> (SMT 专用网站)

## 咨询窗口

株式会社 FUJI 机器人应用事业本部 (咨询页面)

<https://smt.fuji.co.jp/cn/contact/>